

# 株主の皆さまへ

## 第48期 中間報告書

2025年4月1日から2025年9月30日まで



TOWA  
キャラクター  
トワッピー

### トップメッセージ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに、当社第48期中間報告書（2025年4月1日から2025年9月30日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当中間連結会計期間における世界経済は、米国の関税政策による不透明感が続いたものの、各国の政策支援や一部地域における内需の堅調さに支えられ、底堅く推移しました。

半導体業界においては、EV市場の成長鈍化による自動車向け需要の低迷や、レガシー半導体の回復の遅れなど、一部では停滞感が残る状況です。一方で、生成AIやデータセンター向けの需要が市場を牽引しており、高性能・低消費電力の半導体技術への投資が加速する中、業界全体としては堅調な成長を維持しています。

このような事業環境のもと、当社グループの当中間連結会計期間における業績は、民生品向け及びメモリ半導体の需要低迷に加え、米国の関税政策の影響により、前年度後半から受注が低迷したことで、第1四半期において売上高の落ち込みが大きく、前年同期比で減収減益となりました。

一方、第2四半期においては、中国、台湾、その他アジア地域を中心に半導体設備投資が徐々に回復しており、受注高及び売上高は増加基調となりました。各段階利益につきましても、当社独自のコンプレッション装置及び金型の売上比率が想定を上回ったことに加え、製品ミックスの改善などにより利益率が向上し、当初予想を上回る結果となりました。

なお、中間配当は見送りとさせていただきますが、期末配当につきましては1株当たり20円を予定しております。

今後とも、株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、グループ一丸となって邁進していく所存でございますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2025年12月



取締役社長執行役員

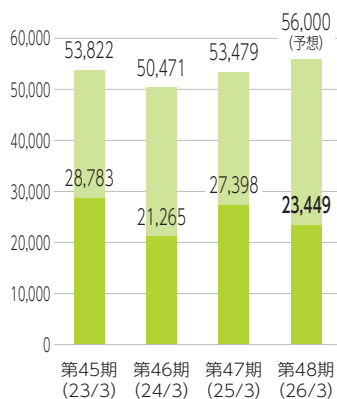
滝谷 宗男

### 業績ハイライト

#### 売上高

(単位:百万円)

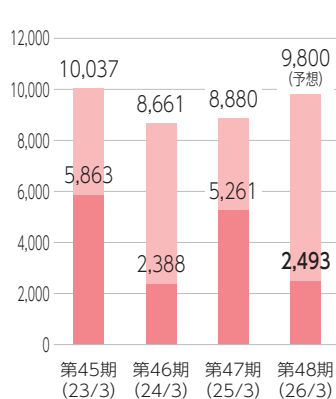
■ 中間期 ■ 通期



#### 営業利益

(単位:百万円)

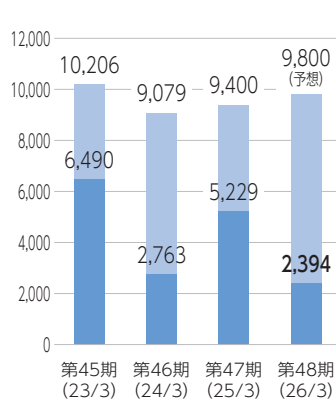
■ 中間期 ■ 通期



#### 経常利益

(単位:百万円)

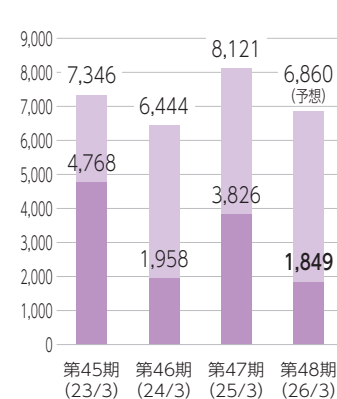
■ 中間期 ■ 通期



#### 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益

(単位:百万円)

■ 中間期 ■ 通期





## トピックス

### 韓国における新工場の稼働を開始

当社グループのTOWA韓国株式会社は、2025年6月に韓国・天安第2工場を完成させ、竣工式を執り行いました。韓国地域では、生成AIの普及などを背景に、先端半導体向けの設備投資が拡大しており、今後も活発な投資が継続すると見込まれています。こうした状況に対応するため、生産能力の拡大と納期短縮を目的に新たな生産拠点を整備しました。本工場は、従来比約2倍の生産能力を備えるとともに、試作品製作や技術検証が可能なラボ機能を併設しており、装置導入前の性能確認や共同開発の場としても活用されます。お客様に当社の技術を直接ご体感いただける場として、信頼性向上や提案力強化にも貢献します。今後は、ラボ機能の活用や装置リニューアル事業の強化を通じて、さらなる事業展開と新たなビジネス機会の創出を目指してまいります。



### パッケージ形状にとらわれないシンギュレーション技術確立

当社は、半導体の多様化ニーズに対応するため、レーザ事業を展開する子会社であるTOWAレーザーフロント株式会社と共同で新たなシンギュレーション技術を開発しました。本技術は、従来のブレードによる切断では困難であった異形状パッケージにも対応可能となり、半導体設計の自由度向上や実装効率の改善が期待できます。また、レーザによるドライプロセスにより、切断工程での水使用量を100%削減し、環境負荷の低減にも貢献します。さらに、リードフレーム上で自由なチップ配置を可能にし、お客様の生産性向上とコスト効率の改善にも寄与します。本技術を搭載した新製品「LSG1040」は2025年3月より販売を開始しました。すでに複数の引き合いを受けており、今後の市場拡大が期待されています。

### JOINT3参画で次世代半導体パッケージ技術開発を加速

当社は、株式会社レゾナックが日本、米国、シンガポールなどの半導体材料・装置・設計企業27社とともに設立した、次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画いたします。本コンソーシアムは、参画企業による共創を通じて、パネルレベル有機インターポーザーに適した材料・装置・設計ツールの開発を加速することを目的としています。近年、次世代半導体の需要が急速に拡大する中、PLP（パネルレベルパッケージ）を活用したインターポーザーの大型化は、世界中の業界関係者から大きな注目を集めています。当社はモールドディング技術を活かし、PLPプロセス構築や参画企業の発展、そして半導体業界のさらなる成長に貢献してまいります。



### 持続的成長を支える組織づくり：エンゲージメントサーベイを実施

「TOWAビジョン2032」の達成に向けた基盤づくりの一環として、社員がやりがいを持って働ける職場環境の構築を目指し、エンゲージメントサーベイを実施しました。社員は当社にとって最も重要な財産であり、エンゲージメントの向上は人財資本戦略の重要な柱と位置づけています。今回のサーベイ結果は、現状の可視化に寄与するとともに、得られた結果や課題に対し、社員が一丸となって取り組むことで、「TOWAビジョン2032」で掲げる売上高1,000億円および高利益率の達成に向けた推進力となることが期待されます。

## 会社の概要 (2025年9月30日現在)

商号	TOWA株式会社 (英文名 TOWA CORPORATION)
設立	1979年4月17日
資本金	8,985,585,053円
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎ (075) 692-0250 (代表)
従業員数	726名 (単体) 2,186名 (連結)
上場取引所	東京証券取引所プライム市場

## 株式の状況 (2025年9月30日現在)

●発行可能株式総数	240,000,000株
●発行済株式の総数	75,157,367株
●株主数	55,492名
●大株主	

株主名	持株数	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	6,947 (千株)	9.25 (%)
株式会社ケイビー恒産	5,700	7.59
株式会社エヌレガロ	3,780	5.03
株式会社日本カストディ銀行	2,256	3.00
株式会社京都銀行	2,099	2.80
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	1,820	2.42
セントラル短資株式会社	999	1.33
TOWA社員持株会	919	1.22
JP MORGAN CHASE BANK 385781	875	1.17
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	810	1.08

(注1) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の持株数は、信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式 (43,563株) を控除して計算しております。

## 役員 (2025年9月30日現在)

代表取締役会長	岡田博宗	和田和男
取締役社長執行役員	三浦耕信	田一隆
取締役専務執行役員	石柴西	原村彦弘
取締役常務執行役員	柴西	西野志輔
取締役上席執行役員	矢野和	輝大
取締役執行役員	中服田	部美
社外取締役	矢野和	部美
取締役常勤監査等委員	和後	田方
社外取締役監査等委員	和後	田方
社外取締役監査等委員	和後	田方
社外取締役監査等委員	和後	田方
常務執行役員	田中	秀利
常務執行役員	田中	秀利
執行役員	田中	秀利
執行役員	田中	秀利
執行役員	田中	秀利

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
定時株主総会	毎年6月
基準日	株主総会権利行使及び期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
郵便物の郵送先及び 電話お問い合わせ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)
株主総会資料の電子提供 制度 (書面交付請求) に ついてのお問い合わせ先	みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 ☎0120-524-324 (電子提供制度専用フリーダイヤル)
未払い配当金のお支払	みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 株式会社みずほ銀行 本店及び全国各支店
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL <a href="https://www.towajapan.co.jp">https://www.towajapan.co.jp</a>

